

第二十八届中国国际高新技术成果交易会
THE 28th CHINA HI-TECH FAIR

亚洲半导体与集成电路产业展

Asia Semiconductors and Integrated Circuits Industry Exhibition

2026年11月26日-28日 深圳国际会展中心(宝安)

November 26-28, 2026 Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an)



股票代码：834316

主办单位：

深圳市人民政府

承办单位：

振威国际会展集团

深圳振威国际展览有限公司



高交会——中国科技第一展

中国国际高新技术成果交易会(以下简称“高交会”)自1999年以来已成功举办了二十七届,是我国高新技术领域对外开放的重要窗口和高新技术成果交流交易的重要平台,与广交会、进博会并称为中国三大国家级展会,被誉为“中国科技第一展”。

第二十七届高交会亚洲半导体与集成电路产业展由深圳市人民政府主办、深圳振威国际展览有限公司与深圳市半导体行业协会联合主办,350余家半导体与集成电路领域的优质企业齐聚鹏城,十余场精彩论坛接连上演,华大九天、万里眼、曦华科技、江波龙、洲明科技、开阳电子、机科股份等重磅亮相,实现展品展示、首发首秀、技术发布、学术交流、商贸对接五大核心板块的深度融合。

2026年,亚洲半导体与集成电路产业展作为高交会的核心专题展之一,将深入覆盖半导体材料、化合物半导体、IC设计、晶圆制造设备、半导体设备核心零部件、先进封装等全产业链的关键环节。完整展示集成电路产业链,充分挖掘行业发展新需求,共同开拓市场新机遇,向业界全面展示国内外的科技创新技术与应用成果。

● 第二十七届高交会部分数据

400,000m²
展示面积

5000+
品牌展商

450,000+
专业观众

120+
国家和地区

200+
场专业活动

高交会亚洲半导体与集成电路产业展的六大优势

集群优势:深圳已构建“上游支撑性行业-中游生产-下游应用场景”体系,拥有新凯来、华大九天、鹏芯微、国微集团、华为、比亚迪等知名企业。并相继成立了南山智园、深圳湾科技园等半导体与集成电路产业集聚区,拥有较为完善的上下游产业链布局,集群效应显著,有效降低企业协作成本,加速技术迭代与成果转化。

01

政策优势:深圳“十五五”提到,发挥高交会等展会平台牵引作用,扩大集成电路等产业优势,加强集成电路等领域关键核心技术攻关。此外,深圳还将半导体与集成电路产业作为重点布局和打造的“20+8”产业集群之一,以及《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》出台实施。

02

市场优势:深圳是中国最大的芯片集散地和应用市场,对半导体芯片、集成电路模块等核心产品需求旺盛,涵盖消费电子、新能源汽车、人工智能、物联网、云计算等多个高增长领域。同时,深圳还是链接世界的开放枢纽,产品辐射全球市场,能充分满足参展企业对接国内外的双重需求,拓展客户资源与市场份额。

03

金融优势:深圳市半导体与集成电路产业投资基金“赛米产业私募基金”总规模50亿元,将主要投向深圳市半导体与集成电路重点项目和细分龙头企业,以及其他对完善深圳市半导体产业链有重大作用的项目。此外,深圳汇聚了大量银行、创投机构、券商等金融资源,形成了覆盖企业种子期、成长期、成熟期的全生命周期金融服务体系。

04

科技优势:深圳是国内高新技术产业集聚度最高、市场化程度最高、开放活力最强的城市之一。2025年末,深圳有效期内“小巨人”企业总量达到1333家,标志着深圳正式成为中国“专精特新第一城”。同时,深圳拥有众多高校、科研院所及企业研发中心,形成了产学研深度融合的创新生态,为产业持续提供技术支撑与人才储备。

05

平台优势:亚洲半导体与集成电路产业展能够共享高交会——“中国科技第一展”的国家级平台资源。第二十七届高交会吸引了全球120多个国家和地区的专业观众,三天累计入场突破45万人次,现场发布新产品新成果5000余项,同期举办重大活动200余场,共促成1023项供需对接和投融资项目签约,意向成交与投融资金额突破1700亿元。

06



展示范围

半导体材料

硅片、硅基材料、抛光垫、掩膜版、溅射靶材、抛光液、刻蚀溶液、陶瓷封装材料、封装基板、光刻胶、特种气体、超纯水

IC设计

EDA/IP、处理器芯片、存储芯片、数字芯片、模拟芯片、汽车电子芯片、消费电子芯片、工业级芯片

半导体设备核心零部件

射频电源、射频发生器、阀门、真空泵、阀芯、静电吸盘、密封圈、传送模块、气体流量计、精密轴承、运动控制器、镀膜材料、精密运动平台、机械臂、反应腔喷淋头

化合物半导体

碳化硅SiC、氮化镓GaN、立方氮化硼CBN、SiC晶体生长炉、SiC衬底及外延片、GaN衬底及外延片、SiC功率器件、GaN功率器件

晶圆制造设备

刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、光刻机、涂胶显影设备、减薄设备、湿法处理设备、清洗设备、抛光设备、量测检测设备

先进封装

倒装芯片封装、晶圆级封装、2.5D封装、3D封装、凸块封装、扇外型晶圆级封装、探针台、测试机、分选机、X-ray检测设备

同期活动

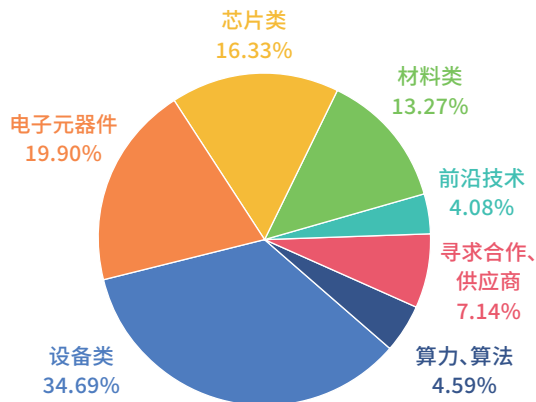


- ◆ 半导体关键技术攻坚与前沿创新论坛
- ◆ 系列颁奖典礼
- ◆ 半导体项目推介发布会
- ◆ 半导体全产业链生态建设论坛
- ◆ 国际采购发布会
- ◆ 国际投融资对接大会

往届展商



采购意向



数据来源于2025年展会现场

新闻媒体

70亿次
全网曝光



超3000家
国内外媒体



15000余次
海内外媒体跨年度报道



企业展位服务方案

豪华展位

19,800元/12m²

豪华展位

31,600元/18m²

光地 (36m²起售)

1,580元/m²



微信公众号



视频号



官方微信

为配合企业的市场战略,我们将提供更多方案选择,更多需求请来电话咨询。

振威国际会展集团 深圳振威国际展览有限公司

地址:深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道6099号星港同创汇天枢座705-706

电话:0755-85242014

官网:<https://semiexpo.com/>